

NDiS series

Interactive Signage Platform Product Selection Guide

リテールソリューション セレクトカタログ Vol.2

NDiSシリーズ導入事例

デジタルサイネージプレーヤ NDiS B シリーズ

国内向けサポートサービスとオプションサービスのご案内

ODMサービス / ネクスコムIoTソリューション



NDiS series

NEXCOM Smart Retail Solution Tailored to Your Needs

インタラクティブ サイネージ プラットフォーム
- スマートリテールソリューション -

IoT

Smart Shelf Management Solution

顧客の性別や年齢などに合わせた広告コンテンツの切り替えや、視聴者の測定による広告効果分析などにより、効率的なプロモーションが可能です。

Checkout Counters

Queue Efficiency Management

リアルタイム映像解析による待ち行列管理は、効率的な人員配置を可能にし、スムーズな会計により顧客満足度の向上が期待できます。

Promotion Shelves

Customer Traffic Patterns Analytics

人流計測データの可視化により、店舗内の来客の導線や滞留箇所を把握し、商品提案や製品陳列の効率化を図ることが可能です。

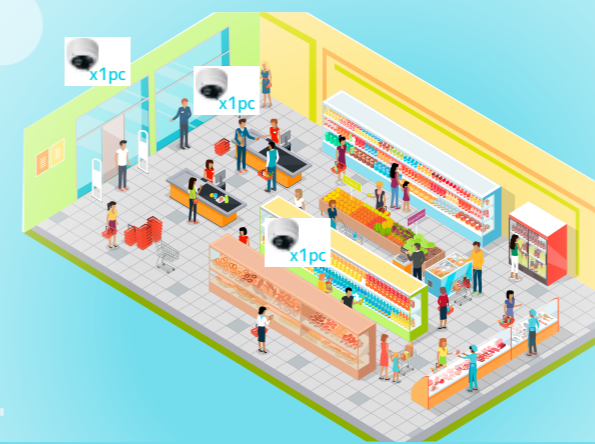
Door Entrance

People Counting Analytics

通行・来店者数などのデータを収集し、購買者のエンゲージメントや来店から購入までのコンバージョン率等の分析を可能にします。



Small Retail Store (150m²)



NDiS B325-SI3

エントランスや商品棚、チェックアウトカウンタに個別に設置されたカメラの情報も一台で収集、情報分析が可能。

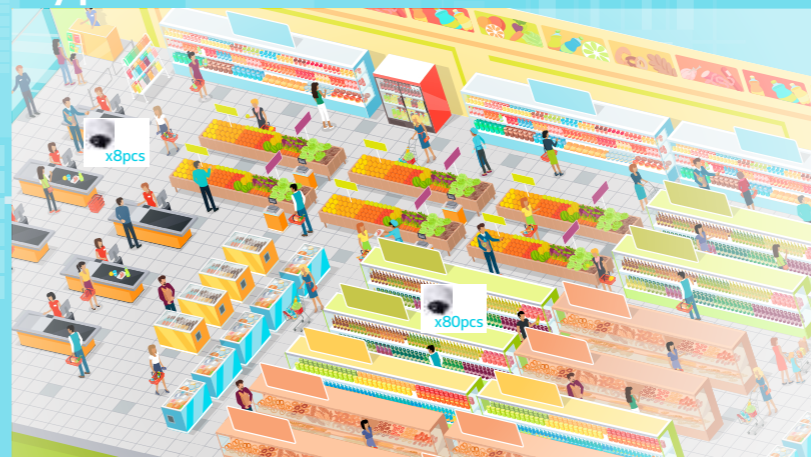
Supermarket (1,500m²)



NDiS B535

エントランスや商品棚、チェックアウトカウンタに加え、電子棚札システムも、ハイパフォーマンスサイネージプレイヤーで対応。

Hypermarket (6,000m²)



NDiS B535

3Dカメラの使用で4K解像度のレベルの高いトラフィック測定を実現、店舗内の状況を明瞭にとらえ、顧客の統合分析を実現。

- Plan marketing and promotion campaigns -
- Enhance customer service -
- Optimize sales performance -

NEXCOM導入事例1 バンコク・タイ

デジタルサイネージプレーヤ NDiS B325-S15

Quick Service
Restaurant



NEXCOM デジタルサイネージプレーヤによる QSR セルフサービスオーダーシステムの自動化

世界最大のファストフードチェーンのひとつが、サービスの拡大と注文プロセスのスピードアップのために一部店舗でセルフサービススタンドの導入に着手しています。待ち時間を短縮し快適で便利な注文体験を提供することを狙いとして、同ファストフードチェーンはカウンタでの注文と同じようにインタラクティブな店舗内デジタルエクスペリエンスの構築を目指していました。そこでインタラクティブ機能を備えたタッチスクリーンとセルフチェックアウト機器に対応した販売システムが必要となった同チェーンは、最終的に NEXCOM のデジタルサイネージプレーヤにたどり着きました。

販売スタンドに組み込まれた NEXCOM デジタルサイネージプレーヤには、直感的な注文インターフェースを提供する 42 インチの大型タッチスクリーンディスプレイや外付けプリンタ、RFID、支払用の POS リーダといったセルフチェックアウト機器が接続されています。デジタルサイネージプレーヤは Ethernet 接続で、店舗

のキッチンディスプレイシステム (KDS) とコンテンツサーバにも接続されますので、特別プロモーションや日替り特価品などを含め、カウンタで提供可能なメニューすべてを同期してセルフサービススタンドに表示することが可能です。顧客はサービスカウンタの場合と同様にセルフサービススタンドから注文を行えるだけでなく、お好みのトッピングやソースなどを選択して注文内容をカスタマイズすることも可能です。

支払にはクレジットカードや非接触型スマートカードを利用でき、支払を終えると注文番号の入ったレシートがプリントアウトされます。顧客は KDS 画面で注文状況や受取のタイミングを確認できます。NEXCOM のデジタルサイネージプレーヤを利用したセルフサービススタンドで、初めから終わりまでデジタル化されたサービスカウンタエクスペリエンスを提供することで、同チェーンは列待ち時間の短縮だけでなくサービス機能の拡大や利益率の改善まで実現することができます。



NDiS B325-S15

- Intel® Core™ i5-6200U プロセッサ
- 2画面ディスプレイ対応 HDMI x2 ポート
- KIOSK 端末に最適な -20°C ~ 50°C 動作温度範囲
- ファンレスデザイン





NEXCOM導入事例2 東京・日本

デジタルサイネージプレーヤ NDiS B533

東京駅「東京中央通路電照デジタルシートセット」※イメージ



J・AD ビジョン

NEXCOM のサイネージプレーヤが支える JR 東京駅の 4K 対応デジタルサイネージ「J・AD ビジョン」

デジタルサイネージとシート広告をセット展開する「東京中央通路電照デジタルシートセット」では、2015年のリニューアルの際、JR 東日本エリアに展開する J・AD ビジョンおよび J-Spot ビジョンでは初の 4K 対応サイネージを採用しました。

日本を代表するターミナル駅の一つである JR 東京駅、その中でも流動率の高い中央通路コンコースには、8本の柱に 14面のデジタルサイネージ、J・AD ビジョンが設置されており、一画面に 1台、

4K2K 放映用 STB (セットトップボックス) として、ネクスコムの NDiS B533 が使用されています。

70 インチ・ディスプレイ放映対応のリニューアルにより、従来の 2K サイネージ (1,920x1,080 ピクセル) から、高解像度 4K (3,840x2,160 ピクセル) の表示が可能となり、データ配信には高速データ通信 WiMAX を採用、曜日別・時間帯別・各ディスプレイ別にフレキシブルなコンテンツの表示変更が可能となります。

4K 画質対応に加え、従来のハイビジョン画質の映像をより高画質で表示できるようになり、より訴求力のある広告展開を可能にしています。

4K対応 J・ADビジョン



電照シート広告

NDiS B533

- ・ 第 4 世代 Intel® Core™ プロセッサファミリー
- ・ Intel® HD4600 Graphics
- ・ 3画面ディスプレイ対応 HDMI x3 ポート
- ・ ファンレスデザイン



NDiS B325 / NDiS B325-SI3 / NDiS B325-SI5

低価格ハイパフォーマンス 3種類のCPUモデルをラインナップした4K対応バリューモデル

NDiS B325 は低価格で実現するハイスペック STB として産業用グレードに特化することなく、低価格と薄型をテーマに、ほとんどのデジタルサイネージシーンにおいて、ポイントとなるスペックはすべて兼ね備えています。

ローエンドの Celeron® 版 (NDiS B325) とミドル・ハイエンドの2種類 (NDiS B325-SI3/B325-SI5) は搭載 CPU をそれぞれ Celeron® N3150 または低消費 Core プロセッサとし、上位機種に引けを取らないパフォーマンスを発揮いたします。NDiS B325 は STB のエントリーモデルとしての使用に最適です。



NDiS B325 前面



NDiS B325 背面



NDiS B325-SI3 / NDiS B325-SI5 前面



NDiS B325-SI3 / NDiS B325-SI5 背面

モデル	NDiS B325	NDiS B325-SI3	NDiS B325-SI5
CPU	Intel® Celeron® N3150 (Quad Core, 1.6GHz)	Intel® Core™ i3-6100U (Dual Core, 2.3GHz)	Intel® Core™ i5-6200U (Dual Core, 2.3GHz)
グラフィクス	Intel® HD Graphics	Intel® HD520 Graphics	←
メモリ	DDR3L SO-DIMM ソケット x 1 最大8GB	DDR4 SO-DIMM ソケット x 1 最大8GB	←
COMポート	RS232 x 1	←	←
LANポート	LAN x 1	←	←
USBポート	USB3.0 x 4, USB2.0 x 2	←	←
ビデオ	HDMI x 1, VGA x 1	HDMI x 2	←
オーディオ	Audio-out x 1, Mic x 1	←	←
拡張スロット	Mini-PCIe スロット x 1	M.2 x 1	←
ストレージ	2.5インチベイ x 1	←	←
DC入力	+19V	←	←
ACアダプタ	65W ACアダプタ付属	←	←
外形寸法 (WxDxH)(mm)	226 x 147 x 29	←	←
重量 (Kg)	1.5	←	←
動作温度範囲	-20°C~50°C	←	←

NDiS B533 (NDiS B533F ファン搭載モデル)

第4世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 4K ビデオ再生対応デジタルサイネージプレーヤ



NDiS B533 はベストセラーの NDiS 163/166 を継承した第4世代 Intel® Core™ プロセッサを搭載するハイパフォーマンス STB です。

冒頭の事例でご紹介させていただいたように、日本国内でも多くの実績を持っております。先代に比べ大きく性能が向上した Intel® HD グラフィックスなど、4K 等の新しいコンテンツにも対応いたします。



NDiS B533 前面

CPUタイプ：第4世代 Intel® Core™ プロセッサ
搭載可能 CPU：
Core i3-4350T (Dual Core, 3.1GHz)
Core i5-4570TE (Quad Core, 2.7GHz)
Core i7-4770TE (Quad Core, 2.3GHz)

- Intel® Q87
- Intel® HD4600 Graphics
- DDR3 SO-DIMM ソケット x 2 最大16GB
- RS232 x 2, LAN x 2, USB3.0 x 4
- HDMI x 3, Line-out x 1, Line-in x 1, SPDIF x 1

- Mini-PCIe スロット x 2
- 2.5インチベイ x 1, SATA DOM x 1
- SIMスロット x 1
- +12V / 80W ACアダプタ付属

外形寸法 294mm (W) x 198mm (D) x 52mm (H)

重量 3.5 kg

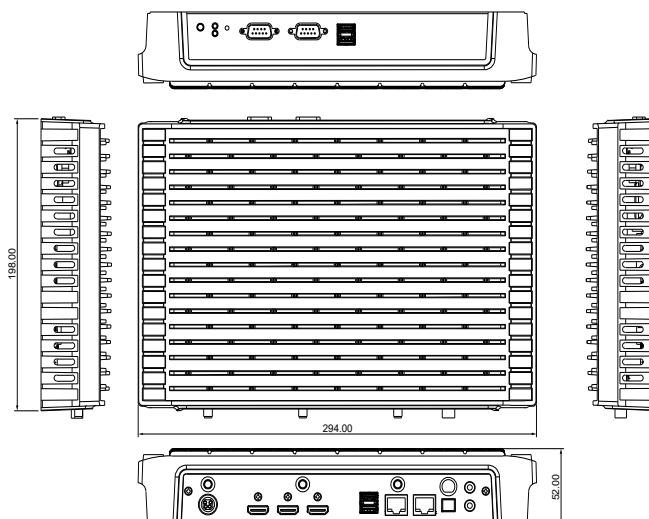
動作温度範囲 0°C ~ 40°C



NDiS B533 前面



NDiS B533 背面



NDiS B535 (NDiS B535F ファン搭載モデル)

第6世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 4K ビデオ再生対応デジタルサイネージプレーヤ



NDiS B535 は B533 を継承し同一デザインに第6世代 Intel® Core™ プロセッサを搭載し、Intel® HD530 グラフィックスにより、多彩な映像表現を可能としました。4K のマルチ出力も可能です。ケースはアルミを使用しファンレスとしての放熱に重点をおいて設計しました。さらにオプションでケース内に2個のファンを搭載可能で劣悪な温度環境にも対応いたします。



NDiS B535 前面

CPUタイプ：第6世代 Intel® Core™ プロセッサ
搭載可能CPU：
Core i3-6100TE (Dual Core, 2.7GHz)
Core i5-6500TE (Quad Core, 2.3GHz)
Core i7-6700TE (Quad Core, 2.4GHz)

- Intel® Q170
- Intel® HD530 Graphics
- DDR4 SO-DIMM ソケット x 2 最大32GB
- RS232 x 4, LAN x 2, USB3.0 x 6
- HDMI x 3, Line-out x 1, Mic x 1

- Mini-PCIe スロット x 1, M.2 x 2
- 2.5インチベイ x 1
- SIMスロット x 1
- +12V / 96W ACアダプタ付属

外形寸法 294mm (W) x 198mm(D) x 52mm (H)

重量 3.5 kg

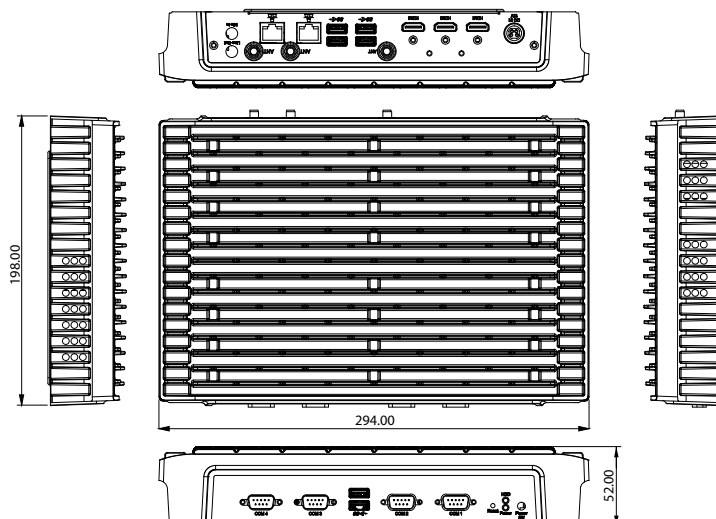
動作温度範囲 0°C ~ 40°C



NDiS B535 前面



NDiS B535 背面



NDiS B537

第7世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 4K ビデオ再生対応スリム型デジタルサイネージプレーヤ



NDiS B537 は第7世代 Intel® Core™ プロセッサを搭載し従来機に比べ約 10% の性能向上を実現しました。さらにケースも従来の 52mm から 33mm へと約 35% もスリム化し、よりフレキシブルな設置を可能とします。オプションの LTE モジュールを搭載すると直接通信可能となり、STB のみならず高性能デジタルサイネージ向け IoT ゲートウェイとしても使用可能です。



NDiS B537 前面

CPU タイプ：第7世代 Intel® Core™ プロセッサ
搭載可能 CPU：
Core i3-7101E (Dual Core, 3.9GHz)
Core i5-7500T (Quad Core, 2.7GHz)
Core i7-7700T (Quad Core, 2.9GHz)

- Intel® H110
- Intel® HD630 Graphics
- DDR4 SO-DIMM ソケット x 2 最大32GB
- RS232 x 2, LAN x 1, USB3.0 x 4
- HDMI x 2, Line-out x 1, Mic x 1

- Mini-PCIe スロット x 1, M.2 x 1
- 2.5インチベイ x 1
- SIMスロット x 1
- +12V / 96W ACアダプタ付属

外形寸法 295mm (W) x 189.9mm (D) x 33mm (H)

重量 2.5 kg

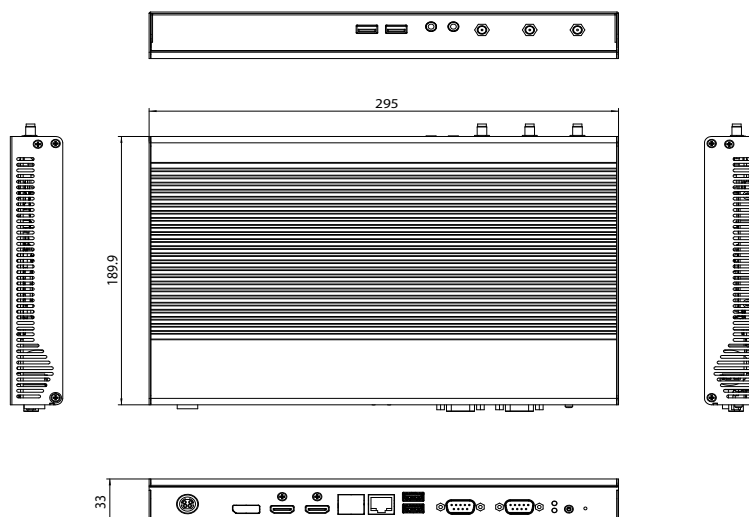
動作温度範囲 0°C~40°C



NDiS B537 前面



NDiS B537 背面



充実の国内向けサポートメニュー

ミニマムロットは1台から

1台より受注

最低発注数は、システム1台より承ります。

面倒な組立てはお任せ

アSEMBリサービス

ご希望のCPU、メモリ、ストレージ、拡張カードなど、各種アSEMBリサービスもお任せ下さい。

各種キッティング

インストール・キッティング

ご希望のOS・アプリケーションのインストール、ご指定のCDなどの添付品の同梱等、各種キッティング作業も承ります。

信頼性を高めます

出荷前検査の実施

出荷前にエージングテスト、負荷テスト等を実施します。貴社ご指定の検査や評価レポートの添付などにも対応します。

安心の国内サポート

修理・技術サポート

修理や技術サポートを実施します。修理レポートの作成など、国内でのサポート体制を整えています。

貸出無料

評価機貸出

ネクコムの製品を無料にてお貸出しします。導入前のパフォーマンスの確認や評価にご利用ください。

修理サポートサービス

18ヶ月間の無償修理保証（標準保証）

標準品は弊社発送日より18ヶ月間の無償修理保証が添付されています。（保証書を発行しない出荷履歴管理システムにより、出荷商品の詳細は弊社で管理しております）

国内での修理対応

ネクコム・ジャパンにて修理が可能な場合は、国内修理により短期間にて返却します。

センドバックによる受付

修理品を弊社まで発送頂き、弊社にて不良状況の確認・解析・修理を実施します。

本社 (NEXCOM International) での修理対応

ネクコム・ジャパンにて修理が不可能な場合は、本社のRMAセンターへ発送します。

その他オプションサービス

最長5年延長保証のオプションサポート ワランティプログラム

ネクコム・ジャパン ワランティプログラムは、NDiS シリーズ等の弊社製品をシステムで購入いただいた際に、所定の費用を購入時、お支払いいただくことにより、最長5年間修理費用が無償になるプログラムです。

※詳細は別紙ワランティ規定をご覧ください。

USBでメモリブートし、簡単リカバリ リカバリUSBメモリ添付サービス

製品を購入時にリカバリ USB メモリ添付サービスをオプションにてご利用頂けます。万が一の障害発生時に、CD/DVDドライブがなくてもPCを製品出荷時の状態に戻します。また、お客様のアプリケーションを含めたオリジナルのリカバリUSBメモリも作成可能です。（※ Windows OS のみ対応）

何回でも修理費無料！

年8%とリーズナブル

2,3,4,5年間の選択可

1台から対応

標準保証
18か月



延長保証(オプション)

安心の
延長保証

最大5年間



簡単復旧！

アプリケーションも含めて複数のバックアップファイルが作成できる！



カラーチェンジやインターフェースのカスタマイズ ステッカー製作などオリジナルブランド品の制作をお手伝い

ODMソリューションその① キッティングサービス

Windows や Linux や貴社専用のアプリケーションのインストールなど各種キッティングサービスを行います。貴社での面倒なインストール作業を削減し、到着したその日からすぐにお使い頂けます。

ODMソリューションその② ソフトのカスタマイズ

BIOS のカスタマイズ（ロゴ表示・デフォルト値の変更）や WindowsOS のイメージ作成・構築をはじめ各種アプリケーション開発のお手伝いも可能です。詳しくは弊社営業部までご相談下さい。弊社パートナーをご紹介させて頂きます。

ODMソリューションその③ パネルのステッカー製作

ステッカーの製作は 200 枚から承ります。ステッカーを弊社でお預かりし、本体ご注文時に貼り付けて出荷致します。

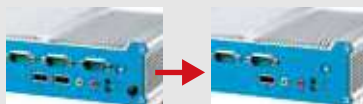


ODMソリューションその④ カラーチェンジ

ケースのカラーチェンジは 200 台ロットより対応致します。また社名やロゴ、インターフェース名の変更も可能です。

ODMソリューションその⑤ ボードのカスタマイズ

ボード上のコンポーネントの取外しや変更など、I/O や機能のカスタマイズが可能です。



ODMソリューションその⑥ 各種認証取得

標準にて CE と FCC 認証を取得していますが、ご希望に合わせて、VCCI や UL、CCC などの取得手続きを別途行います。

ネクコム・ジャパンオリジナル ネクコムIoTソリューション

LTE通信内蔵対応、モバイルネットワークで 遠隔制御・稼働監視・遠隔保守・メンテナンスを実現

LTE通信専用アンテナ一覧



簡易アンテナ



ルーフトップアンテナ



マグネットアンテナ



ウインドアンテナ

SIMCom Wireless Solution社製



NTTドコモLTE/3G対応モジュール

型式名	SIM7100J-MPCle (LTE/3G)
アクセス方式	FDD/TDD-LTE
ダウンリンク	最大100Mbps (LTE)
アップリンク	最大50Mbps (LTE)
動作温度	-30~80℃

ソフトバンクLTE/3G対応モジュール

型式名	SIM7100E-MPCle (LTE/3G)
アクセス方式	FDD-LTE
ダウンリンク	最大100Mbps (LTE)
アップリンク	最大50Mbps (LTE)
動作温度	-30~80℃

メーカー	サガ電子工業					
品名	1 簡易アンテナ	2 ルーフトップアンテナ		3 マグネットアンテナ		4 ウインドアンテナ
型名	821B-2.5-SMAP	RTA827L-5-SMAP	RTA827L-10-SMAP	MG827L-5-SMAP	MG827L-10-SMAP	827-5-SMAP
外形寸法(mm)	80 x 40 x 20	154 x 34 x 10		154 x 34 x 10		142 x 34 x 10
ケーブル長(m)	2.5	5	10	5	10	5
動作温度	-30℃~85℃					
取付方法	両面テープ/フック	ねじ(M3)		マグネット		吸盤(M4)

●会社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。●このカタログに記載されている内容は製品改良のため、予告なく仕様・デザイン等を変更する場合があります。●このカタログの記載内容は2017年6月現在のものです。



株式会社ネクコム・ジャパン

〒108-0014 東京都港区芝4-11-5 田町ハラビル9階
TEL : 03-5419-7830 FAX : 03-5419-7832
Email : sales@nexcom-jp.com
URL : <http://www.nexcom-jp.com>

本製品に関するお問い合わせは